**PARA DIFUSIÓN INMEDIATA CONTACTO**

Terry Emerson

[terry.emerson@samtec.com](mailto:terry.emerson@samtec.com)

812-981-8304

**[SAMTEC LOGO] Junio 2018**

**Samtec presenta la tarjeta de interconexión de alta densidad y paso ultrafino más avanzada del mercado**

El zócalo para tarjeta de interconexión con paso de 0,50 mm ahorra espacio y costes

**New Albany (Indiana, EE.UU.):** Samtec anuncia el primer zócalo para tarjeta de interconexión (edge) MEC5 con paso de 0,50 mm y haz de alineación. Este diseño cubre la demanda de menor tamaño y mayor velocidad, además de optimizar el coste.

El haz de alineación del zócalo se ha diseñado para alinear la tarjeta con los contactos. Esto permite aplicar una tolerancia estándar de la placa en las tarjetas, algo que no sería aceptable habitualmente para conectores de paso ultrafino. Ello optimiza los costes de fabricación ya que el ahorro de costes en las placas de circuito impreso es del 30-50%, además del alto rendimiento obtenido con tarjetas estándar.

La densidad muy elevada de este zócalo para tarjeta de interconexión con paso ultrafino de 0,50 mm ofrece un increíble ahorro de espacio si se compara con las soluciones más comunes con un paso de 0,80 mm. Este zócalo, disponible en ángulo vertical (MEC5-DV) y ángulo recto (MEC5-RA), incorpora más de 300 E/S en total para aplicaciones de alta densidad.

El zócalo vertical está diseñado para ofrecer un rendimiento de 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 con el fin de cubrir la demanda del mercado en cuanto a velocidad. Ambas orientaciones están diseñadas para el manejo de señalización PCIe® Gen 4.

“Me complace anunciar el sistema de tarjeta de interconexión MEC5 ya que añadirá otra capa a la muy amplia oferta de tarjetas de interconexión de Samtec”, declaró Terry Emerson, responsable de productos de alta velocidad de Samtec, Inc. “La capacidad de utilizar las tolerancias estándar de la placa, con un paso tan denso, no es algo que se suela encontrar en el mercado. Esto permitirá que nuestros clientes introduzcan señales de alta velocidad en un conector de muy alta densidad y mantener la placa conectada a un coste razonable”.

Este sistema, con una corriente nominal de 1,5 A por contacto, acepta tarjetas con un grosor de 0,062 pulgadas (1,60 mm) e incorpora patillas de alineación estándar y polarización de tarjeta. Existen diversas pestañas de soldadura robustas que se encuentran disponibles para montaje por inserción o montaje superficial con el fin de obtener una conexión segura a la placa.

Para más información, visite [la página web de Samtec sobre sistemas para tarjetas Micro Edge.](https://www.samtec.com/connectors/edge-card/high-speed/micro-edge-card)

Las marcas PCI-SIG®, PCI Express® y PCIe® son marcas registradas y/o marcas de servicio de PCI-SIG.

**Acerca de Samtec, Inc.**

Samtec fue fundada en 1976 y es un fabricante de una amplia línea de soluciones de interconexión electrónica con presencia mundial y una facturación de 713 millones de dólares. Entre sus productos se encuentran soluciones de Circuitos Integrados (CI) a placa y de encapsulado de CI, de placa a placa a alta velocidad, cables de alta velocidad, interconexiones ópticas para placas intermedias y paneles, apilamiento flexible, y componentes y cables micro/robustos. Los centros tecnológicos de Samtec se dedican al desarrollo de tecnologías avanzadas, estrategias y productos que optimizan las prestaciones y el coste de un sistema desde la pastilla de semiconductor sin encapsular hasta una interfase situada a 100 metros, y con todos los puntos de interconexión situados entre medio. Con sus 33 sedes en 18 países, la presencia mundial de Samtec le permite ofrecer un servicio al cliente incomparable. Para más información, visite <http://www.samtec.com>.

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Tel.: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[www.samtec.com](http://www.samtec.com)